

**Environmental testing - Part 2-58: Tests
- Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution
of metallization and to soldering heat of
surface mounting devices (SMD)**

Environmental testing - Part 2-58: Tests - Test Td:
Test methods for solderability, resistance to
dissolution of metallization and to soldering heat of
surface mounting devices (SMD)

EESTI STANDARDI EESSÕNA

NATIONAL FOREWORD

Käesolev Eesti standard EVS-EN 60068-2-58:2004 sisaldab Euroopa standardi EN 60068-2-58:2004+AC:2004 ingliskeelset teksti. Käesolev dokument on jõustatud 16.11.2004 ja selle kohta on avaldatud teade Eesti standardiorganisatsiooni ametlikus väljaandes. Standard on kättesaadav Eesti standardiorganisatsioonist.	This Estonian standard EVS-EN 60068-2-58:2004 consists of the English text of the European standard EN 60068-2-58:2004+AC:2004. This document is endorsed on 16.11.2004 with the notification being published in the official publication of the Estonian national standardisation organisation. The standard is available from Estonian standardisation organisation.
--	---

Käsitlusala: Outlines test Td, applicable to surface mounting devices, which are intended to mount on substrates. This standard provides the standard procedures for solder alloys containing lead and for lead-free solder alloys. Provides standard procedures for determining the solderability and resistance of soldering heat to lead-free solder alloys and for determining the solderability, dissolution of metallization (see B.3.3) and resistance of soldering heat to solder alloys which are eutectic or near eutectic tin lead solders. Include the solder bath method and reflow method.	Scope: Outlines test Td, applicable to surface mounting devices, which are intended to mount on substrates. This standard provides the standard procedures for solder alloys containing lead and for lead-free solder alloys. Provides standard procedures for determining the solderability and resistance of soldering heat to lead-free solder alloys and for determining the solderability, dissolution of metallization (see B.3.3) and resistance of soldering heat to solder alloys which are eutectic or near eutectic tin lead solders. Include the solder bath method and reflow method.
---	---

ICS 19.040, 31.190

Võtmesõnad: environmental testing, resistance to dissolution of metallization, resistance to soldering heat, solderability, surface mounting devices

English version

Environmental testing**Part 2-58: Tests –****Test Td: Test methods for solderability,
resistance to dissolution of metallization and
to soldering heat of surface mounting devices (SMD)
(IEC 60068-2-58:2004)**

Essais d'environnement

Partie 2-58: Essais –

Essai Td: Méthodes d'essai
de la soudabilité, de la résistance
de la métallisation à la dissolution
et de la résistance à la chaleur
de soudage des composants
pour montage en surface (CMS)
(CEI 60068-2-58:2004)

Umweltprüfungen

Teil 2-58: Prüfungen –

Prüfung Td: Prüfverfahren für
Lötbarkeit, Widerstandsfähigkeit
gegenüber Auflösen der Metallisierung
und Lötwärmebeständigkeit
bei oberflächenmontierbaren
Bauelementen (SMD)
(IEC 60068-2-58:2004)

This European Standard was approved by CENELEC on 2004-09-01. CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CENELEC member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CENELEC members are the national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CENELEC

European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

Foreword

The text of document 91/447/FDIS, future edition 3 of IEC 60068-2-58, prepared by IEC TC 91, Electronics assembly technology, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as EN 60068-2-58 on 2004-09-01.

This European Standard supersedes EN 60068-2-58:1999.

This European Standard includes the following significant technical changes with respect to EN 60068-2-58:1999:

- expansion of the scope so that it includes lead-free solder alloy in addition to the existing tin-lead eutectic or near eutectic solder alloy (the structure of the document has been changed accordingly);
- addition of the definitions "solderability" and "resistance to soldering heat" for SMDs;
- specification of the re flow temperature profiles for the resistance to soldering heat using lead-free solder;
- addition of an Annex C enabling a quick overview of the test conditions.

The following dates were fixed:

- | | | |
|--|-------|------------|
| – latest date by which the EN has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement | (dop) | 2004-12-01 |
| – latest date by which the national standards conflicting with the EN have to be withdrawn | (dow) | 2005-06-01 |

Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 60068-2-58:2004 was approved by CENELEC as a European Standard without any modification.

In the official version, for Bibliography, the following notes have to be added for the standards indicated:

IEC 60068-2-4	NOTE	Harmonized as EN 60068-2-4:1995 (not modified).
IEC 60068-2-54	NOTE	Harmonized as EN 60068-2-54:1987 (not modified).
IEC 60068-2-69	NOTE	Harmonized as EN 60068-2-69:1996 (not modified).

Annex ZA (normative)

Normative references to international publications with their corresponding European publications

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

NOTE Where an international publication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant EN/HD applies.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 60068-1	1988	Environmental testing Part 1: General and guidance	EN 60068-1 ¹⁾	1994
IEC 60068-2-20	1979	Part 2: Tests - Test T: Soldering	HD 323.2.20 S3 ²⁾	1988
IEC 60194	1999	Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions	-	-
IEC 60749-20	2002	Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat	EN 60749-20	2003
IEC 61190-1-1	2002	Attachment materials for electronic assembly Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly	EN 61190-1-1	2002
IEC 61190-1-2	2002	Attachment materials for electronic assembly Part 1-2: Requirements for solder pastes for high-quality interconnections in electronics assembly	EN 61190-1-2	2002
IEC 61190-1-3	2002	Attachment materials for electronic assembly Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications	EN 61190-1-3	2002
IEC 61191-2	1998	Printed board assemblies Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies	EN 61191-2	1998

¹⁾ EN 60068-1 includes corrigendum October 1988 + A1:1992 to IEC 60068-1:1988.

²⁾ HD 323.2.20 S3 includes A2:1987 to IEC 60068-2-20.

<u>Publication</u>	<u>Year</u>	<u>Title</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Year</u>
IEC 61249-2-7	2002	Materials for printed boards and other interconnecting structures Part 2-7: Reinforced base materials clad and unclad - Epoxide woven E-glass laminated sheet of defined flammability (vertical burning test), copper-clad	EN 61249-2-7	2002
IEC 61760-1	1998	Surface mounting technology Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)	EN 61760-1	1998

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60068-2-58

Troisième édition
Third edition
2004-07

Essais d'environnement –

Partie 2-58:

Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

Environmental testing –

Part 2-58:

Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60068-2-58:2005

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE

CEI
IEC

INTERNATIONAL
STANDARD

60068-2-58

Troisième édition
Third edition
2004-07

Essais d'environnement –

Partie 2-58:

Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

Environmental testing –

Part 2-58:

Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)

© IEC 2005 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

U

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	4
1 Domaine d'application et objet	8
2 Références normatives	8
3 Termes et définitions	10
4 Ensemble des procédés de brasage utilisant des alliages de brasure sans plomb	10
5 Préconditionnement.....	12
6 Méthode du bain de brasage.....	12
6.1 Appareillage d'essai et matériaux pour la méthode du bain de brasage	12
6.2 Procédure d'essai pour méthode de bain de brasage	14
7 Méthodes de refusion de soudure	16
7.1 Appareillage d'essai et matériaux pour les méthodes de refusion de soudure.....	16
7.2 Procédure d'essai pour la méthode de refusion de soudure	20
8 Conditions d'essais.....	22
8.1 Conditions d'essai pour les alliages de soudure de brasure sans plomb.....	22
8.2 Conditions d'essai pour les alliages de brasure contenant du plomb	26
9 Mesures finales	30
9.1 Nettoyage du flux	30
9.2 Conditions de reprise.....	30
9.3 Évaluation	32
10 Renseignements devant figurer dans la spécification applicable	34
Annexe A (normative) Critères pour examen visuel.....	38
Annexe B (informative) Guide	42
Annexe C (informative) Vue d'ensemble des conditions d'essais.....	48
Bibliographie	52
Figure 1 – Exemples d'immersion.....	16
Figure 2 – Profil de température de refusion.....	22
Figure 3 – Identification des zones sur les bornes métalliques	32
Figure A.1 – Évaluation du mouillage	40
Tableau 1 – Ensemble des procédés de brasage se rapportant aux alliages de brasure sans plomb.....	12
Tableau 2 – Sévérités (durées et températures) – Méthode de bain de brasage – Alliages de brasure sans plomb.....	24
Tableau 3 – Profil de température de refusion pour le mouillage – Alliages de brasure sans plomb.....	24
Tableau 4 – Profil de température de refusion pour la résistance à la chaleur de brasage – Alliages de brasure sans plomb	26
Tableau 5 – Sévérités (durée et température).....	26
Tableau 6 – Profil de température de refusion pour le mouillage – Alliages de brasure contenant du plomb	28
Tableau 7 – Profil de température de fusion pour la résistance à la chaleur de brasage – Alliages de brasure contenant du plomb	30
Tableau C.1 – Aperçu des conditions de température et de durée.....	50

CONTENTS

FOREWORD.....	5
1 Scope and object.....	9
2 Normative references	9
3 Terms and definitions	11
4 Grouping of soldering processes using lead-free solder alloys	11
5 Preconditioning	13
6 Solder bath method	13
6.1 Test apparatus and materials for the solder bath method.....	13
6.2 Test procedure for solder bath method	15
7 Solder reflow methods	17
7.1 Test apparatus and materials for solder reflow methods	17
7.2 Test procedure for the solder reflow method.....	21
8 Test conditions	23
8.1 Test conditions for lead-free solder alloys	23
8.2 Test conditions for lead containing solder alloy.....	27
9 Final measurements	31
9.1 Flux removal.....	31
9.2 Recovery conditions	31
9.3 Evaluation	33
10 Information to be given in the relevant specification.....	35
Annex A (normative) Criteria for visual examination.....	39
Annex B (informative) Guidance.....	43
Annex C (informative) Overview of test conditions	49
Bibliography	53
Figure 1 – Examples of immersion	17
Figure 2 – Reflow temperature profile.....	23
Figure 3 – Identification of areas on metallic termination.....	33
Figure A.1 – Evaluation of wetting	41
Table 1 – Grouping of soldering processes related to lead-free solder alloys.....	13
Table 2 – Severities (duration and temperatures) – Solder bath method – Lead-free solder alloys	25
Table 3 – Reflow temperature profile for wetting – Lead-free solder alloys	25
Table 4 – Reflow temperature profile for resistance to soldering heat – Lead-free solder alloys	27
Table 5 – Severities (duration and temperature)	27
Table 6 – Reflow temperature profile for wetting – Lead containing solder alloys.....	29
Table 7 – Reflow temperature profile for resistance to soldering heat – Lead containing solder alloys	31
Table C.1 – Overview of the temperature and duration conditions	51

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60068-2-58 a été établie par le comité d'études 91 de la CEI: Techniques d'assemblage des composants électroniques.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport à l'édition précédente:

- extension du domaine d'application de manière à inclure l'alliage de brasage sans plomb en plus de l'alliage de brasage étain-plomb eutectique ou quasi eutectique existant (la structure du document a été modifiée en conséquence);
- ajout des définitions de «brasabilité» et de «résistance à la chaleur de brasage» pour les CMS;
- spécification des profils de température de fusion pour la résistance à la chaleur de brasage utilisant de la soudure sans plomb;
- ajout d'une Annexe C permettant un rapide aperçu des conditions d'essais.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ENVIRONMENTAL TESTING –

**Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability,
resistance to dissolution of metallization and to
soldering heat of surface mounting devices (SMD)**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60068-2-58 has been prepared by IEC technical committee 91: Electronics assembly technology.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- expansion of the scope so that it includes lead-free solder alloy in addition to the existing tin-lead eutectic or near eutectic solder alloy (the structure of the document has been changed accordingly);
- addition of the definitions of "solderability" and "resistance to soldering heat" for SMDs;
- specification of the reflow temperature profiles for the resistance to soldering heat using lead-free solder;
- addition of an Annex C enabling a quick overview of the test conditions.

Cette version bilingue (2005-02) remplace la version monolingue anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 91/447/FDIS et 91/459/RVD.

Le rapport de vote 91/459/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

This bilingual version (2005-02) replaces the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
91/447/FDIS	91/459/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

ESSAIS D'ENVIRONNEMENT –

Partie 2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai de la soudabilité, résistance de la métallisation à la dissolution et résistance à la chaleur de brasage des composants pour montage en surface (CMS)

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 60068 décrit l'essai Td applicable aux composants pour montage en surface (CMS) qui sont destinés à être montés sur des substrats. La présente norme fournit les procédures normalisées pour les alliages de brasage contenant du plomb (Pb) et pour les alliages de brasage sans plomb.

La présente norme fournit des procédures normalisées pour déterminer la brasabilité et la résistance à la chaleur de brasage des alliages de brasage sans plomb.

La présente norme fournit des procédures normalisées pour déterminer la brasabilité, la dissolution de la métallisation (voir B.3.3) et la résistance à la chaleur de brasage des alliages de brasage qui sont des brasures étain-plomb eutectiques ou quasi eutectiques.

Les procédures de la présente norme incluent la méthode du bain de brasage ainsi que la méthode de soudure par refusion. La méthode du bain de brasage est applicable aux CMS conçus pour le brasage à la vague et aux CMS conçus pour le brasage par fusion lorsque la méthode du bain de brasage (immersion) est appropriée. La méthode de soudure par refusion est applicable aux CMS conçus pour le brasage par fusion, pour déterminer l'adaptabilité des CMS au procédé de brasage par fusion et lorsque la méthode du bain de brasage (immersion) n'est pas appropriée.

Le but de la présente norme est de s'assurer que la sortie du composant ou la brasabilité de ses extrémités est en mesure de satisfaire aux exigences applicables aux joints de soudures de la CEI 61191-2 en utilisant chacune des méthodes de brasage spécifiées dans la CEI 61760-1. En outre, les méthodes d'essai sont fournies pour s'assurer que le corps du composant peut résister à la charge calorifique à laquelle il est exposé pendant le brasage.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-1:1988, *Essais d'environnement – Partie 1: Généralités et guide*

CEI 60068-2-20:1979, *Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai T: Soudure*

CEI 60194:1999, *Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées – Termes et définitions* (disponible en anglais seulement)

CEI 60749-20:2002, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 20: Résistance des CMS à boîtier plastique à l'effet combiné de l'humidité et de la chaleur de soudage*

ENVIRONMENTAL TESTING –

Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface mounting devices (SMD)

1 Scope and object

This part of IEC 60068 outlines test Td, applicable to surface mounting devices (SMD), which are intended to mount on substrates. This standard provides the standard procedures for solder alloys containing lead (Pb) and for lead-free solder alloys.

This standard provides standard procedures for determining the solderability and resistance of soldering heat to lead-free solder alloys.

This standard provides standard procedures for determining the solderability, dissolution of metallization (see B.3.3) and resistance of soldering heat to solder alloys which are eutectic or near eutectic tin lead solders.

The procedures in this standard include the solder bath method and reflow method. The solder bath method is applicable to the SMD designed for flow soldering and the SMD designed for reflow soldering when the solder bath (dipping) method is appropriate. The reflow method is applicable to the SMD designed for reflow soldering, to determine the suitability of SMD for reflow soldering and when the solder bath (dipping) method is not appropriate.

The objective of this standard is to ensure that component lead or termination solderability meets the applicable solder joint requirements of IEC 61191-2 using each of the soldering methods specified in IEC 61760-1. In addition, test methods are provided to ensure that the component body can resist against the heat load to which it is exposed during soldering.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1:1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-20:1979, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering*

IEC 60194:1999, *Printed board design, manufacture and assembly – Terms and definitions*

IEC 60749-20:2002, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 20: Resistance of plastic-encapsulated SMDs to the combined effect of moisture and soldering heat*

CEI 61190-1-1:2002, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-1: Exigences relatives aux flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les assemblages de composants électroniques*

CEI 61190-1-2:2002, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-2: Exigences relatives aux crèmes de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les assemblages de composants électroniques*

CEI 61190-1-3:2002, *Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques – Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages à braser de catégorie électronique et brasures solides fluxées et non fluxées pour les applications de brasage électronique*

CEI 61191-2:1998, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 2: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage pour montage en surface*

CEI 61249-2-7:2002, *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion – Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués – Feuille stratifiée tissée de verre E avec de la résine époxyde, d'inflammabilité définie, (essai de combustion verticale), plaquée cuivre*

CEI 61760-1:1998, *Technique du montage en surface – Partie 1: Méthode de normalisation pour la spécification des composants montés en surface (CMS)*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions définis dans la CEI 60068-1, dans la CEI 60068-2-20 et dans la CEI 60194 (en anglais seulement), ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1

brasabilité

aptitude de la borne ou de l'électrode du CMS à être mouillée par la brasure à la température de la borne ou de l'électrode qui est supposé être la température la plus basse du procédé de brasage dans la plage de températures brasables de l'alliage de brasure

3.2

résistance à la chaleur de brasage

aptitude des CMS à résister à la température la plus importante de la borne ou de l'électrode du procédé de brasage dans la gamme de températures applicable des alliages de brasure

4 Ensemble des procédés de brasage utilisant des alliages de brasure sans plomb

Les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb actuellement sélectionnées pour les processus industriels sont significativement différentes de celles de l'alliage de brasure Sn-Pb. De plus, les températures de fusion des alliages de brasure sans plomb sont différentes les unes des autres, mais peuvent être regroupées.

Selon la capacité des CMS à résister aux conditions typiques de température et de temps de maintien qui adapte l'exposition au processus utilisant les alliages sélectionnés sans plomb, l'ensemble des procédés de brasage suivants indiqués dans le Tableau 1 sont donnés comme références pour sélectionner la rigueur des essais de mouillage et de résistance à la chaleur de brasage spécifiée: